

ClayTec HFA dun

Art. 09.009 D = 8 mm

- Emissiearme houtvezelafbouwplaat (HFA)
- Leempleister-draaglaag in de houtbouw
- Dun en voordelig



Dunne houtvezelafbouwplaat (HFA) als pleisterdrager op hout en houtachtige plaatmaterialen. De platen kunnen worden vastgeschroefd of vastgeniet. Zo ontstaat op hout op zeer eenvoudige wijze een veilige ondergrond voor de wapeningslaag van leemlijm- en wapeningsmortel en de daaropvolgende leemafwerking. Naast dit productblad gelden de **ClayTec-richtlijnen voor "Low-emission drywall systems"**.

ClayTec HFA dun

Art. 09.009 D = 8 mm

Toepassingsgebied Houtvezelafbouwplaat (HFA) als pleisterdrager in de houtbouw voor ClayTec leempleisters binnenshuis. Voor het volledig bekleden van massiefhouten bouwelementen, beschot en houtachtige plaatmaterialen. Geschikt voor oppervlakken van waterinwerkingsklasse W0-I volgens DIN 18534-1, bijvoorbeeld in badkamers, met uitzondering van douchegebieden, en in huishoudelijke keukens. Met wapeningslaag geschikt als ondergrond voor YOSIMA leem-designpleister, ClayTec afwerkpleem fijn 06 met ClayTec leemverf gebruiksklare of het ClayFix leemverfsysteem.

Samenstelling Houtvezels

Bouwstofwaarden Druksterkte ≥ 100 kPa, volumieke massa 230 kg/m^3 , warmtegeleidingswaarde $0,05 \text{ W/mK}$, $\mu 5$. Warmteopslag: $C_p 2,1 \text{ kJ/kgK}$, $3,9 \text{ kJ/m}^2\text{K}$. Brandgedrag volgens DIN EN 13501-1: E.

Afmetingen D = 8 mm, L = 1.200 mm, B = 600 mm. Oppervlak per plaat = $0,72 \text{ m}^2$.

Leveringsvorm 276 platen per eenwegpallet.

Opslag Liggend op pallets en droog opslaan. Opslag is onbeperkt mogelijk. Tijdens transport en opslag op de bouwplaats beschermen tegen vocht. Op de bouwplaats liggend en vlak opslaan op droge pallets of houten balken. Randen beschermen tegen beschadiging.

Luchtvochtigheid Vochtbelasting door nat aangebrachte pleisters en dekvloeren is niet toegestaan. In het algemeen mag de relatieve luchtvochtigheid tijdens opslag en na montage niet hoger zijn dan 70%.

Materiaalbehoefte Bij het bepalen van de materiaalbehoefte rekening houden met een reserve van ca. 10% voor snijverlies enz.

Ondergrond De ondergrond moet draagkrachtig, vorstvrij, droog, schoon, bij houtachtige plaatmaterialen stofvrij, vrij van zoutbelasting, voldoende ruw en zuigend zijn. Beschadigingen grof herstellen. Zanderige ondergronden indien nodig fixeren met ClayTec diepgrondering en versteviger.

Het vochtgehalte van bekledingsondergronden van massiefhouten bouwelementen, beschot en houtachtige plaatmaterialen moet worden gecontroleerd vanwege mogelijke droogvervormingen en daaropvolgende schade aan bekleding en coatings.

Verwerking De platen worden gesneden met een decoupeerzaag, cirkelzaag of stanleymes.

De onderste platenrij wordt met enige afstand, ofwel "lucht", tot de vloer gemonteerd.

Op massief hout vindt vlakke bevestiging plaats met schroeven (ClayTec leembouwplaat Schroeven met een afstand van 200 mm). In de regel worden de platen echter bevestigd met nieten, bijvoorbeeld Haubold nieten serie KG 700 (ETA-goedkeuring), met een indringdiepte van 18 mm. Op houtachtige plaatmaterialen zo lang mogelijke nieten gebruiken zonder de platen te doorboren. De afstand tussen de nieten bedraagt ca. 150 mm; de randafstand bedraagt 25 mm, gemeten vanaf het midden van de niet. De nieten moeten vlak met het oppervlak worden ingedreven en mogen niet verzonken worden.

Kruisvoegen en het doorzetten van begrenzingen van wandopeningen via horizontale of verticale voegen zijn niet toegestaan. De platen worden verwerkt met verticale stootvoegen die minstens 20 cm, bij voorkeur 30 cm, verspringen.

Verdere behandeling Voor voeg- en coatingwerkzaamheden mag de ruimtetemperatuur niet lager zijn dan ca. $+10^\circ\text{C}$. In principe moet de vochtinbreng door het bepleisteren zo laag mogelijk worden gehouden. De rondom lopende plaatvoeg langs de wand wordt gesloten met ClayTec leem-voegenvuller.

Platen zorgvuldig ontstoffen. Spleten ≥ 1 mm breed over de volledige doorsnede diepte vullen met fijne leemmortel en laten drogen.

Dunne laagafwerking: Schroefgaten en beschadigingen vooraf sluiten. Na droging de oppervlakken 3 mm dik overtrekken met ClayTec hechtpleem en wapeningsmortel. Deze kan ook met de pleistermachine worden aangebracht; rusttijden van de mortel zijn dan niet nodig. In het nog natte oppervlak wordt glasweefsel 112 over het volledige oppervlak ingebed. Na droging YOSIMA leem-designpleister vakkundig met een geschuurd oppervlak uitvoeren; een gladde uitvoering is niet mogelijk. Als alternatief kan de wapeningslaag schilderklaar worden uitgevoerd met een nat-in-nat laag van 1 mm dikte, of na droging worden overwerkt met leem-afwerkpleister fijn 06 of leemvul- en vlakplamuur (Q3). Afwerking met gebruiksklare ClayTec leemverf of het ClayFix leemverfsysteem.

Dikke laagafwerking: Oppervlakken voorbehandelen met de primer DE RODE. Basisleem met stro, leempleister mineraal 20 of SanReMo aanbrengen in een laagdikte van max. 8 mm op wandvlakken en max. 5 mm op plafond- of schuine dakvlakken. In het nog natte oppervlak glasvezelwapening 112 over het volledige oppervlak inbedden. Laten drogen. Totale pleisteropbouw dikte: wand max. 15 mm, plafond- of schuine dakvlakken max. 10 mm, telkens in minstens twee lagen.

Wandverwarming: De oppervlakken voorbereiden met de primer DE RODE of door hechtpleem en wapeningsmortel met een getande spaan aan te brengen. Laten drogen. Een voorsproei laag tot max. 8 mm aanbrengen met een van de bovengenoemde leempleistermortels. Na droging opvullen tot aan de buiskruin van de wandverwarming. Droging van de volledige onderpleister met verwarmingsondersteuning is mogelijk. Zie voor meer informatie het ClayTec Werkblad leempleisters.

Op snijvlakken kan in zeldzame gevallen lignine doorslaan. Deze zones kunnen met gangbare afsluitmiddelen worden geblokkeerd.

De kennis van de **ClayTec-richtlijnen voor "Low-emission drywall systems"** is voor de verwerking van de producten absoluut noodzakelijk.

Klachten die niet het gevolg zijn van fabrieksmatige mengfouten zijn uitgesloten. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Vanaf 2026/9.